





TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS PRACTICA #2 TIPOS DE PROCESADORES

ALUMNO: LUIS ÁNGEL OLIVARES GONZÁLEZ

> NÚMERO DE CONTROL: 20051223



Arquitectura de Computadoras ISC.

Práctica. 2

Objetivo. Conocer más de las características de los procesadores.

Consulta de fichas técnicas (características) de procesos (CPU's) vistos en el laboratorio.

Anexarlos por generación.

INTEL PENTIUM III DE 800 MHz, CACHÉ DE 256 K, FSB DE 133 MHz.

Especificaciones sobre rendimiento.

Cantidad de núcleos: 1

Frecuencia básica del procesador: 800 MHz

Caché: 256 KB L2 CachéVelocidad del bus: 133 MHz

• TDP: 20,8 W

Rango de voltaje VID: 1.75V

Especificaciones del paquete.

Zócalos compatibles: PPGA370, SECC2,

SECC2495 TCASE: 80°C



Intel Pentium 4 531, frecuencia básica de 3,00 GHz y una caché de 1 MB L2

Especificaciones sobre rendimiento

Cantidad de núcleos: 1

Frecuencia básica del procesador: 3,00 GHz

Caché: 1 MB L2 CacheVelocidad del bus: 800 MHz

Paridad FSB: NoTDP: 84 W

Rango de voltaje VID: 1.200V-1.425V

Especificaciones del paquete

Zócalos compatibles: PLGA775

TCASE: 67.7°C

Tamaño de paquete: 37.5mm x 37.5mm

Tamaño del chip de procesamiento: 112 mm2

Cantidad de transistores de chip por procesador: 125 millones



INTEL CELERON, 1.00 GHz, CACHÉ DE 256K, FSB DE 100 MHz.

Especificaciones sobre rendimiento.

- Cantidad de núcleos: 1
- Frecuencia básica del procesador:
- 1,00 GHz
- Caché: 256 KB L2 CachéVelocidad del bus: 100 MHz
- Paridad FSB: NoTDP: 27.8 W
- Rango de voltaje VID: 1.475

Especificaciones del paquete.

- Zócalos compatibles: PPGA370
- TCASE: 69°C
- Tamaño del paquete: 49mm x 49mm
- Tamaño de chip de procesamiento: 80 mm^2
- Cantidad de transistores de chip de procesador: 44 million



INTEL CELERON D 352 CACHÉ DE 512K, 3, 20 GHz, FSB DE 533 MHz.

Especificaciones sobre rendimiento.

- Cantidad de núcleos: 1
- Frecuencia básica del procesador: 3,20 GHz
- Caché: 512 KB L2 Caché
- Velocidad del bus: 533 MHz
- · Paridad FSB: No
- TDP: 86 W
- Rango de voltaje VID: 1.25V 1.325V

Especificaciones del paquete.

- Zócalos compatibles: PLGA775
- TCASE: 69.2°C
- Tamaño de paquete: 37.5mm x 37.5mm
- Tamaño del chip de procesamiento: 81
 - mm^2
- Cantidad de transistores de chip por procesador: 188 million



Intel Xeon DP 3.20 GHz, 2,40 GHz y una caché de 2 MB L2

Especificaciones sobre rendimiento

Cantidad de núcleos: 2

Frecuencia básica del procesador: 2,40 GHz

Caché: 2 MB L2 CacheVelocidad del bus: 533 MHz

Paridad FSB: NoTDP: 105 W

Rango de voltaie VID: 1.100V-1.325V

Especificaciones del paquete

Zócalos compatibles: Socket 604

TCASE: 72.8°C

• Tamaño de paquete: 37.5mm x 37.5mm

Tamaño del chip de procesamiento: 112 mm2

Cantidad de transistores de chip por procesador: 125 millones



Especificaciones sobre rendimiento

Cantidad de núcleos: 2

• Frecuencia básica del procesador: 2,30 GHz

Caché: 2 MB Intel® Smart Cache

Velocidad del bus: 4 GT/s

Paridad FSB: No

TDP: 15 W

Rango de voltaje VID: 0,700V-1,350V

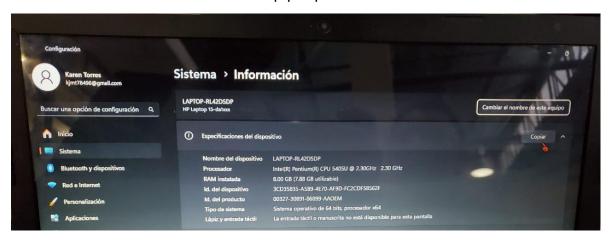
Especificaciones del paquete

Zócalos compatibles: FCBGA1449

• TCASE: 95°C

Tamaño de paquete: 37.5mm x 37.5mm
Tamaño del chip de procesamiento: 10nm

Cantidad de transistores de chip por procesador: 4.200 millones





AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx 2.10 GHz Especificaciones sobre rendimiento

Cantidad de núcleos: 4

• Frecuencia básica del procesador: 2,10 GHz

Caché: 4 MB L2 Cache + 4 MB L3 Cache
Velocidad del bus: 1,200 MHz

Paridad FSB: No

TDP: 15 W

Rango de voltaje VID: 0.700V-1.350V

Especificaciones del paquete

Zócalos compatibles: FP5

TCASE: 95°C

Tamaño de paquete: 37.5mm x 37.5mm
Tamaño del chip de procesamiento: 12nm

Cantidad de transistores de chip por procesador: 4.400 millones

